

行业月度点评

电子

半导体设备销售额高增，国产替代有望提速

2024 年 06 月 24 日

评级

领先大市

评级变动：维持

行业涨跌幅比较



%	1M	3M	12M
电子	3.49	-2.90	-11.39
沪深 300	-4.53	-1.92	-10.02

何晨

执业证书编号:S0530513080001
hechen@hnchasing.com

袁鑫

yuanxin@hnchasing.com

分析师

研究助理

相关报告

- 1 电子行业 2024 年 5 月报：台股 FPCB 企业营收高增，建议关注软板及 HDI 板 2024-05-21
- 2 电子行业 2024 年 4 月报：行业温和复苏，建议关注高多层 PCB 2024-04-25
- 3 半导体行业深度：市场回暖叠加 HPC 题材刺激，封装迎投资机遇 2024-02-01

重点股票	2023A		2024E		2025E		评级
	EPS (元)	PE (倍)	EPS (元)	PE (倍)	EPS (元)	PE (倍)	
沪电股份	0.79	46.67	1.20	30.71	1.40	26.40	增持
深南电路	2.73	38.99	3.37	31.56	4.02	26.46	增持
生益科技	0.50	41.60	0.72	28.39	0.91	22.51	增持

资料来源：iFinD，财信证券

投资要点：

- **市场行情回顾：**5 月 21 日至 6 月 24 日，沪深 300 指数-5.47%，申万一级行业普遍下跌，涨幅中位数为-11.28%，其中申万电子指数+2.48%，排名第 1。申万电子三级行业涨跌互现，涨幅中位数为+0.21%，集成电路封测(+9.7%)、印制电路板(+9.65)、模拟芯片设计(+9.37%)、半导体设备(+8.86%)涨幅居前，印制电路板排名第 2。PE 估值处于历史中值附近，6 月 24 日申万电子整体法 PE-TTM 为 36 倍，处于历史后 47%分位；中位数法 PE-TTM 为 46 倍，处于历史后 41%。
- **半导体及 PCB 市场中长期预测乐观。**1) 2024 年半导体销售额预期乐观，WSTS 预测 2024 年全球半导体市场规模为 5884 亿美元，同比增长 13.1%。2) PCB 市场中长期保持乐观，全球 PCB 市场 2023-2028 年 CAGR 达 5.4%。分产品看，封装基板、18 层及以上高多层板、HDI 板三类产品增长较快，2023-2028 年复合增速分别为 8.8%、7.8%、6.2%。分应用领域看，服务器、汽车为主要增长点。

报告期内，我们发现的边际变化主要如下：

- **半导体销售额同比持续增长，中国增速高于全球水平。**全球半导体销售额 4 月实现 464 亿美元，同比+16.0%；1-4 月累计实现 1861 亿美元，同比+15.7%。中国半导体销售额 4 月实现 142 亿美元，同比+23.8%；1-4 月累计实现 570 亿美元，同比+27.6%。
- **存储芯片价格底部反弹后趋于平缓，出现下行趋势。**6 月 21 日，DDR3、4、5 现货平均价分别为 0.98、3.69、4.85 美元，与 5 月 21 日相比，分别-4.9%、-0.3%、-0.4%；120、256、512GB SSD 行业市场价分别为 6.6、17.8、29.8 美元，与 5 月 14 日相比，分别-7.0%、-3.8%、-6.9%。
- **2024 年一季度中国大陆半导体设备销售额维持高位，同比增长 113.7%。**1) 全球半导体设备销售额 2024Q1 实现 264.2 亿美元，同比-1.5%；2023 年累计实现 1062.5 亿美元，同比-1.3%。2) 中国大陆半导体设备销售额 2024Q1 实现 125.2 亿美元，同比+113.7%；2023 年累计实现 366.0 亿美元，同比+29%。设备销售额大增，有望为国产科技提供有力支持。
- **5 月覆铜板出口额同比+42%。**根据海关数据，印制电路用覆铜板 5 月出口 10160 吨，同比+42%，环比+26%。出口金额实现 0.62 亿美元，

同比+42%，环比+19%。2024 年 1-5 月，覆铜板累计出口累计出口 2.58 亿美元，同比+12%。覆铜板出口金额及数量同比出现明显增长。

- **台湾 PCB 行业营收维持 10+% 增速。**台湾 PCB 厂商 5 月实现营收 603 亿新台币，同比+12%。其中硬板厂商实现营收 450 亿新台币，同比+12%；软板厂商实现营收 153 亿新台币，同比+13%。**服务器相关多层板、HDI 板企业业绩维持高增长**，金象电 5 月营收 34 亿新台币，同比+46%，全年营收同比+39%。软板公司业绩表现亮眼，臻鼎 5 月营收 106 亿新台币，同比+29%，全年营收同比+15%；耀华 5 月营收 17 亿元，同比+21%，全年营收同比+25%。
- **投资建议：**2024 年全球 PCB 市场有望迎来复苏，并在 2024-2028 年保持温和增长。高多层板、HDI 板、封装基板增速较高，并具备更高技术壁垒。根据月度数据判断，预计行业正温和复苏，建议关注 PCB 中具有更高增速及壁垒的细分领域。**1) 数通板：**全球通用人工智能技术加速演进，AI 服务器及高速网络系统的旺盛需求对大尺寸、高速高多层板的需求推动有望持续，建议关注：沪电股份、胜宏科技、深南电路、奥士康、生益电子等。**2) 汽车板：**汽车行业电气化、智能化和网联化等技术升级迭代和渗透率提升将为多层、高阶 HDI、高频高速等方向的汽车板细分市场提供强劲的长期增长机会。建议关注：世运电路、沪电股份、景旺电子、胜宏科技等。**3) 封装基板：**半导体国产化大势所趋，建议关注：积极布局封装载板的深南电路、兴森科技。**4) 覆铜板：**重点关注在高端产品不断取得突破的生益科技、华正新材、南亚新材。
- **风险提示：**市场需求复苏不及预期；产品技术发展不及预期；原材料供应及价格波动风险；经贸摩擦等外部环境风险

内容目录

1 行情回顾	5
2 行业景气度跟踪	6
2.1 半导体及 PCB 市场预测	6
2.1.1 半导体市场预测	6
2.1.2 PCB 市场预测	7
2.2 半导体景气度跟踪	8
2.2.1 半导体销售额	8
2.2.2 存储芯片价格	9
2.2.3 半导体设备销售额	9
2.3 下游需求景气度跟踪	10
3 PCB 原材料跟踪	12
3.1 铜价上涨导致原材料成本波动	13
3.2 覆铜板进出口情况	13
4 台湾半导体及 PCB 行业跟踪	14
4.1 晶圆代工企业	14
4.2 PCB 行业营收情况	15
4.3 PCB 公司营收情况	15
5 行业及公司动态	16
5.1 行业新闻	16
5.1.1 国家集成电路产业投资基金三期成立	16
5.1.2 中低端覆铜板平均涨价 10%	17
5.1.3 TechInsights: 预计中国半导体产能将在五年内增长 40%	17
5.2 公司动态	17
5.2.1 沪电股份: 拟推出不超过 3000 万份股票期权激励计划	17
5.2.2 鹏鼎控股: 5 月合并营业同比增长 23.61%	18
5.2.3 甬矽电子: 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告	18
6 风险提示	18

图表目录

图 1: 申万一级行业 5 月 21 日至 6 月 24 日区间涨跌幅 (%)	5
图 2: 申万电子三级行业 5 月 21 日至 6 月 24 日区间涨跌幅 (%)	5
图 3: 申万电子 PE-TTM (整体法)	6
图 4: 申万电子 PE-TTM (中位数法)	6
图 5: 各机构半导体市场增速预测情况	7
图 6: 2024 年分地区半导体销售额预测情况	7
图 7: 2023-2028 年全球 PCB 分产品 CAGR	8
图 8: 2022-2027 年全球 PCB 分领域 CAGR	8
图 9: 全球半导体月销售额 (亿美元)	8
图 10: 全球半导体年累计销售额 (亿美元)	8
图 11: 中国半导体月销售额 (亿美元)	9
图 12: 中国半导体年累计销售额 (亿美元)	9
图 13: DRAM 现货平均价 (美元)	9
图 14: SSD 市场平均价 (美元)	9

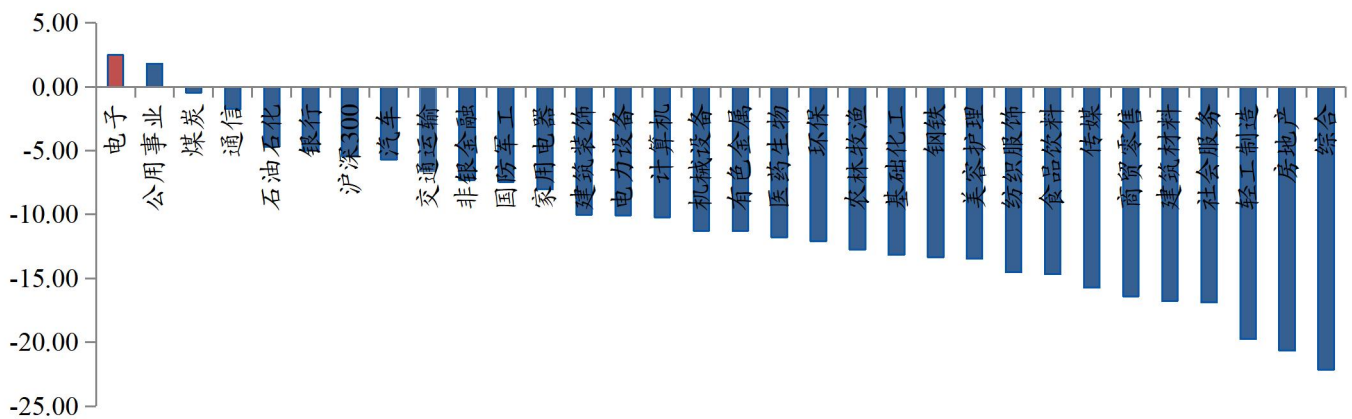
图 15: 全球半导体设备季度销售额 (亿美元)	10
图 16: 全球半导体设备累计销售额 (亿美元)	10
图 17: 中国大陆半导体设备季度销售额 (亿美元)	10
图 18: 中国大陆半导体设备累计销售额 (亿美元)	10
图 19: 中国智能手机月产量 (万台)	11
图 20: 全球智能手机季度出货量 (百万台)	11
图 21: 华硕&宏碁合计营收情况 (亿新台币)	11
图 22: 全球 PC 季度出货量 (万台)	11
图 23: 汽车当月销量 (万辆)	12
图 24: 新能源汽车当月销量	12
图 25: 汽车全年累计销量 (万辆)	12
图 26: 新能源汽车全年累计销量 (万辆)	12
图 27: PCB 成本结构	12
图 28: 覆铜板成本结构	12
图 29: LME 铜现货价 (美元/吨)	13
图 30: 印制电路用覆铜板月进出口数量 (吨)	14
图 31: 印制电路用覆铜板月进出口均价 (美元/吨)	14
图 32: 印制电路用覆铜板月进出口金额 (万美元)	14
图 33: 印制电路用覆铜板年进出口金额 (亿美元)	14
图 34: 台积电月度营收 (亿新台币)	15
图 35: 联电月度营收 (亿新台币)	15
表 1: 申万电子个股涨跌幅 (%)	6
表 2: 全球 PCB 产值 (亿美元) 及增长率预测	7
表 3: 台湾 PCB 行业营收 (亿新台币)	15
表 4: 台股 PCB 公司 5 月营收情况 (亿新台币)	16

1 行情回顾

报告期内，申万电子指数上涨 2.48%。2024 年 5 月 21 日至 6 月 24 日，沪深 300 指数-5.47%，申万一级行业普遍下跌，涨幅中位数为-11.28%，其中申万电子指数+2.48%，排名第 1。

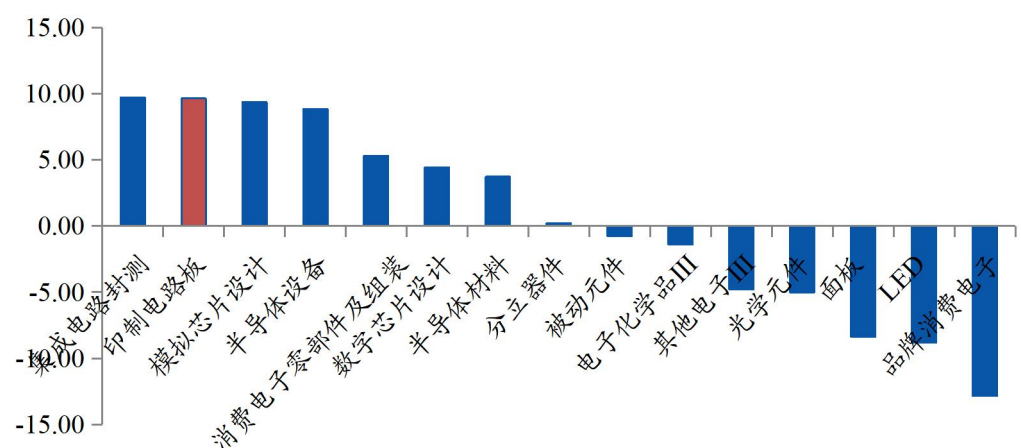
报告期内，申万电子三级行业中 PCB 涨幅居前。2024 年 5 月 21 日至 6 月 24 日，申万电子三级行业涨跌互现，涨幅中位数为+0.21%，集成电路封测（+9.7%）、印制电路板（+9.65）、模拟芯片设计（+9.37%）、半导体设备（+8.86%）涨幅居前，印制电路板排名第 2。

图 1：申万一级行业 5 月 21 日至 6 月 24 日区间涨跌幅（%）



资料来源：同花顺，财信证券

图 2：申万电子三级行业 5 月 21 日至 6 月 24 日区间涨跌幅（%）



资料来源：同花顺，财信证券

个股方面，5月21日至6月24日，申万电子个股涨跌中位数为-2.2%。剔除上市天数不足200天个股及ST股，涨幅前五分别为逸豪新材(+116%)、英力股份(+108%)、金溢科技(+101%)、台基股份(+59%)、满坤科技(+56%)，涨幅后五分别为联建光电(-38%)、亚世光电(-29%)、利通电子(-27%)、商络电子(-26%)、胜蓝股份(-26%)。

表 1: 申万电子个股涨跌幅(%)

涨幅前五名				涨幅后五名			
股票代码	公司简称	主营业务	涨跌幅	股票代码	公司简称	主营业务	涨跌幅
301176.SZ	逸豪新材	铜箔、PCB	+116	300269.SZ	联建光电	LED	-38
300956.SZ	英力股份	结构件模组	+108	002952.SZ	亚世光电	光电显示产品	-29
002869.SZ	金溢科技	车身电子	+101	603629.SH	利通电子	金属结构件	-27
300046.SZ	台基股份	功率半导体	+59	300975.SZ	商络电子	元器件	-26
301132.SZ	满坤科技	PCB	+56	300843.SZ	胜蓝股份	电子连接器	-26

资料来源：同花顺，财信证券

备注：时间区间为2024年5月21日-6月24日

PE估值处于历史中值附近。2019年至今，申万电子板块整体法估值PE-TTM中值为37倍，中位数法估值PE-TTM中值为48倍。2024年6月24日，申万电子整体法PE-TTM为36倍，估值水平处于历史后47%分位；中位数法PE-TTM为46倍，估值水平处于历史后41%分位。

图 3: 申万电子 PE-TTM (整体法)



资料来源：同花顺，财信证券

图 4: 申万电子 PE-TTM (中位数法)



资料来源：同花顺，财信证券

2 行业景气度跟踪

2.1 半导体及 PCB 市场预测

2.1.1 半导体市场预测

多家机构做出乐观预期，半导体销售额2024年有望迎来反弹。多家机构对2024年半导体销售额做出乐观预期，IDC预期增速较高，有望达到20.0%；Tech Insights预期增速偏低，为9.6%；WSTS预期增速较为中性，为13.1%。整体看，2024年全球半导体市场有望出现较为乐观的增长。

从地区看，反弹以美洲及亚太地区为主，WSTS 预测亚太地区增速为 12%。根据 WSTS 于 2023 年 11 月发布的数据，WSTS 预期 2024 年全球半导体市场将达到 5884 亿美元，同比增长 13.1%。其中，美洲地区将达到 1622 亿美元，同比增长 22.3%；欧洲地区将达到 595 亿美元，同比增长 4.3%；日本地区将达到 493 亿美元，同比增长 4.4%；亚太地区将达到 3175 亿美元，同比增长 12%。美洲及亚太地区贡献了主要的增长，欧洲及日本整体规模更小、增长偏缓。

图 5：各机构半导体市场增速预测情况

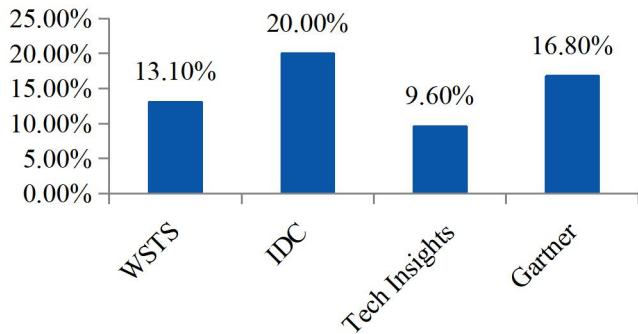
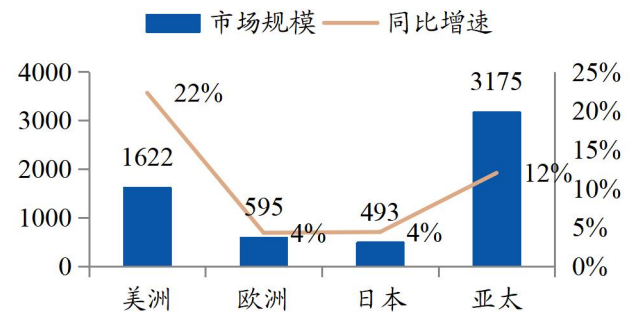


图 6：2024 年分地区半导体销售额预测情况



资料来源：WSTS，IDC，Tech Insights，Gartner，财信证券

资料来源：WSTS，财信证券

2.1.2 PCB 市场预测

PCB 市场有望迎来复苏，预期 2024 年全球 PCB 产值同比增长 4.97%，2023-2028 年 CAGR 可达 5.4%。PCB 行业属于电子信息产品制造的基础产业，受宏观经济周期性波动影响较大。2023 年全球 PCB 产值大幅下滑，同比减少 14.96%；2024 年将迎温和复苏，产值有望达到 730 亿美元，同比增长约 4.97%。长期看，PCB 行业有望实现稳健增长，Prismark 预计全球 PCB 产值在 2023-2028 年的 CAGR 将达到 5.4%。

亚洲（除中国及日本）或将成为 PCB 产业增长核心，2023-2028 年 CAGR 高达 8%。中国 PCB 产值 2024 年预计同比增长 4.1%，2023-2028 年 CAGR 为 4.1%；亚洲（除日本 & 中国）PCB 产值 2024 年预计同比增长 7.5%，2023-2028 年 CAGR 高达 8%。受地缘政治、供应链风险等因素影响，PCB 厂逐渐向泰国、越南等东南亚地区迁移，亚洲（除日本及中国）将成为 PCB 产业的增长中心，上市公司赴海外建厂节奏值得关注。

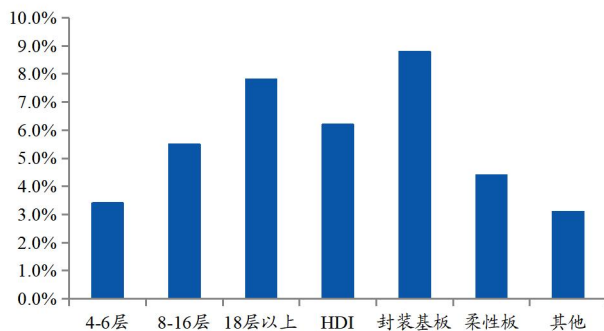
表 2：全球 PCB 产值（亿美元）及增长率预测

	2023 年		2024 年		2023-2028 年 CAGR
	产值	增长率	产值	增长率	
美洲	32.06	-4.80%	33.04	3.10%	3.80%
欧洲	17.28	-8.30%	17.54	1.50%	3.00%
日本	60.78	-16.50%	63.16	3.90%	5.40%
中国	377.94	-13.20%	393.41	4.10%	4.10%
亚洲（除日本&中国）	207.1	-19.30%	222.56	7.50%	8.00%
总计	695.17	-14.96%	729.71	4.97%	5.40%

资料来源：Prismark，财信证券

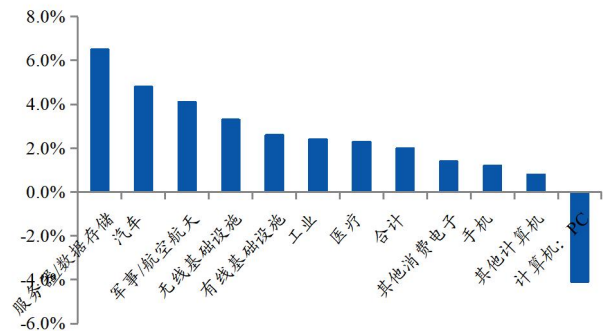
分产品看，封装基板、高多层板及 HDI 板为增长主力。2023-2028 年，封装基板、18 层以上高多层板、HDI 板 CAGR 分别为 8.8%、7.8%、6.2%，快于 PCB 整体的 5.4%。分领域看，服务器/数据存储及汽车领域为增长主力。2022-2027 年，PCB 下游应用领域中，服务器/数据存储、汽车将保持较快增长，CAGR 分别为 6.5%，4.8%。其他消费电子、手机、其他计算机、PC 领域 CAGR 小于整体水平。人工智能、高速网络和汽车系统的强劲需求将继续支持高端 HDI、高速高层和封装基板细分市场的增长，有望为 PCB 行业带来新一轮成长周期。

图 7：2023-2028 年全球 PCB 分产品 CAGR



资料来源：Prismark，财信证券

图 8：2022-2027 年全球 PCB 分领域 CAGR



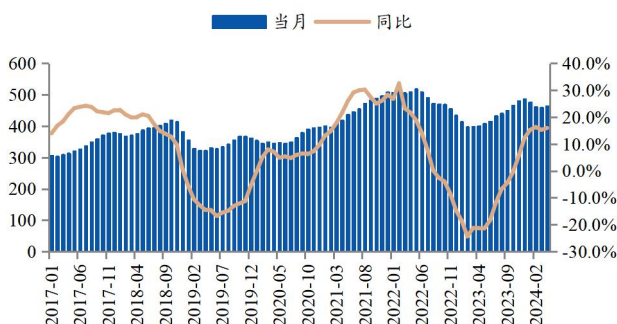
资料来源：Prismark，财信证券

2.2 半导体景气度跟踪

2.2.1 半导体销售额

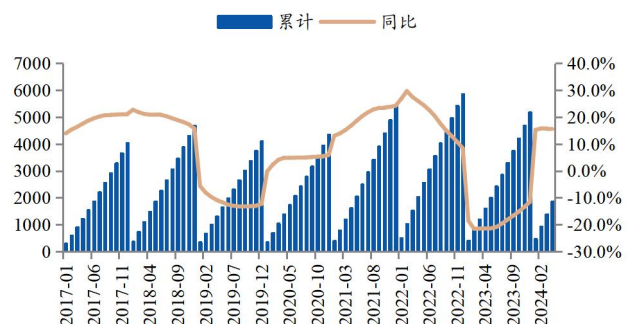
4 月半导体销售额增长强劲，中国同比+26.6%。全球半导体销售额 4 月实现 464 亿美元，同比+16.0%；1-4 月累计实现 1861 亿美元，同比+15.7%。中国半导体销售额 4 月实现 142 亿美元，同比+23.8%；1-4 月累计实现 570 亿美元，同比+27.6%。受去年同期低基数及下游温和复苏影响，2024 年以来的半导体月度销售额同比保持增长，中国半导体销售额增速高于全球水平，低谷后迎来反弹。

图 9：全球半导体月销售额（亿美元）



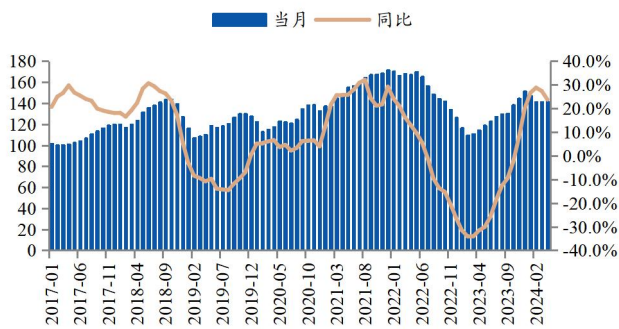
资料来源：SIA，财信证券

图 10：全球半导体年累计销售额（亿美元）



资料来源：SIA，财信证券

图 11: 中国半导体月销售额 (亿美元)



资料来源: SIA, 财信证券

图 12: 中国半导体年累计销售额 (亿美元)



资料来源: SIA, 财信证券

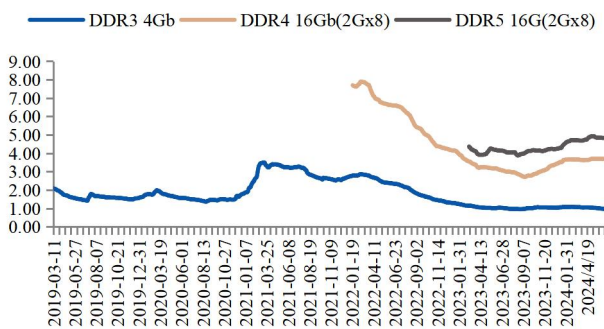
2.2.2 存储芯片价格

存储芯片价格底部反弹后趋于平稳。存储芯片市场规模占集成电路的 30% 左右，且价格存在明显的周期波动，对半导体产业趋势具有指示作用。

DRAM 产品，反弹后趋于平稳，DDR5 更为强劲。6 月 21 日，DDR3、4、5 现货均价分别为 0.98、3.69、4.85 美元，与 5 月 21 日相比，分别-4.9%、-0.3%、-0.4%；与此前最低点价格相比，分别+2.1%、+35.7%、25.0%。成熟产品 DDR3 价格小幅反弹后逐渐回落，当前价格与底部价格相近；主流产品 DDR4、先进产品 DDR5 价格表现更佳，较底部仍有较大涨幅，但过去一个月略显乏力。

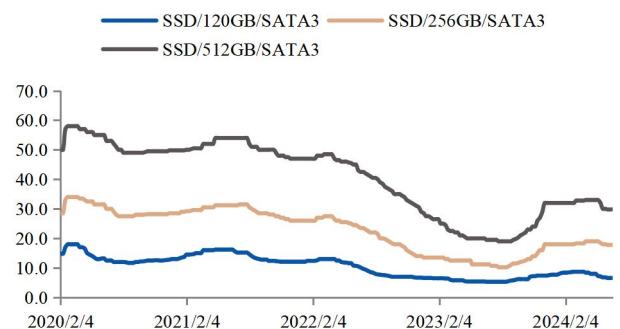
NAND 产品，反弹后趋于平稳，大容量表现更佳。6 月 21 日，120、256、512GB SSD 行业市场价分别为 6.6、17.8、29.8 美元，与 5 月 14 日相比，分别-7.0%、-3.8%、-6.9%，与此前最低点价格相比，分别+25%、+75%、+57%。触底反弹之后，SSD 价格增速放缓，并出现回落，256、512GB 产品价格表现更佳。

图 13: DRAM 现货均价 (美元)



资料来源: DRAMexchange, 财信证券

图 14: SSD 市场均价 (美元)



资料来源: CFM, 财信证券

2.2.3 半导体设备销售额

2020-2022 年大扩产后，全球半导体设备销售额增速短期放缓，中国大陆受自主可控等多重因素影响，半导体设备销售额仍表现亮眼。1) 全球半导体设备销售额 2024Q1 实现 264.2 亿美元，同比-1.5%；2023 年累计实现 1062.5 亿美元，同比-1.3%。2) 中国大陆

半导体设备销售额 2024Q1 实现 125.2 亿美元，同比+113.7%；2023 年累计实现 366.0 亿美元，同比+29%。

2023 年，在全球半导体设备市场规模缩水的背景下，中国大陆市场在二季度开始逆势增长。2024 年一季度，中国大陆半导体设备吸收额仍然保持高增长，同比+113.7%、环比+3.2%。我们推测主要原因是：制裁加剧背景下，半导体产业关键设备的进口需求得到提前释放。

设备销售额大增，有望为国产科技提供有力支持。中长期看，2023 年中旬开始大幅增长的设备进口额，将逐步转换为芯片制造能力，国产芯片产能有望大幅增长。一般情况下，新增产线建设需要约两年时间，考虑选址、建厂等时间缩短等因素，设备投产时间有望进一步缩短。

图 15：全球半导体设备季度销售额（亿美元）



资料来源：SEAJ，财信证券

图 16：全球半导体设备累计销售额（亿美元）



资料来源：SEAJ，财信证券

图 17：中国大陆半导体设备季度销售额（亿美元）



资料来源：SEAJ，财信证券

图 18：中国大陆半导体设备累计销售额（亿美元）



资料来源：SEAJ，财信证券

2.3 下游需求景气度跟踪

PCB 行业下游应用领域基本涉及所有的电子产品，主要应用领域包括通信、3C 类消费电子、计算机及服务器、汽车电子、工控医疗以及航空航天等行业。根据 Prismark 数据，2023 年全球 PCB 下游中，占比靠前的应用主要有手机 18.7%，PC 13.6%，其他消费电子 12.9%，服务器/数据存储 11.8%，有线基础设施 8.6%，无线基础设施 4.6%。

手机：去年下半年手机市场反弹明显，当前反弹趋缓。1) 中国 5 月智能手机产量同比-0.6%，环比+1.3%。根据国家统计局数据，2024 年 5 月全国智能手机产量实现 0.92 亿台，同比减少 0.6%，环比增加 1.3%。2023 年下半年，中国智能手机产量出现明显反弹，9-12 月份产量分别达到 1.13、1.13、1.21、1.29 亿台。2) 2024Q1 全球智能手机出货量同比+7.7%。一季度全球智能手机出货 2.89 亿台，同比增长 7.7%。一季度智能手机市场复苏明显，5 月中国智能手机产量同比持平，表现为传统淡季。

图 19：中国智能手机月产量（万台）



资料来源：国家统计局，财信证券

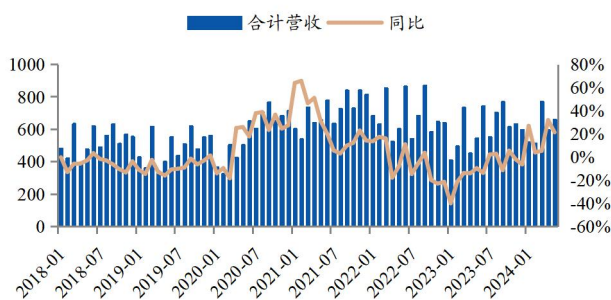
图 20：全球智能手机季度出货量（百万台）



资料来源：IDC，财信证券

PC/平板：华硕&宏碁 5 月合计营收同比增长 21%。2024 年 5 月，华硕&宏碁合计营收 659 亿新台币，同比增长 21%；全年累计营收实现 3059 亿新台币，同比增长 16.1%。2024 年一季度，全球 PC 出货量同比增长 5.1%，环比减少 10.9%。受普及率、产品创新等因素影响，PC 及平板电脑增长相对乏力，叠加疫情期间 PC 及平板需求得到集中释放，近年来 PC/平板需求承压。展望未来，随着换机周期及 AIPC 产品临近，PC 有望迎来复苏。

图 21：华硕&宏碁合计营收情况（亿新台币）



资料来源：同花顺，财信证券

图 22：全球 PC 季度出货量（万台）



资料来源：同花顺，财信证券

汽车：新能源汽车销量维持高增长。2024 年 5 月，全国汽车销量实现 241 万辆，同比+1.2%；新能源汽车销量实现 96 万辆，同比+33.2%；1-5 月，汽车销量累计 1149 万辆，同比+8.2%；新能源汽车销量累计 390 万辆，同比+32.5%。2024 年 1-5 月，新能源汽车渗透率为 33.9%。汽车行业电气化、智能化和网联化等变化不断推进，单车 PCB 价值量

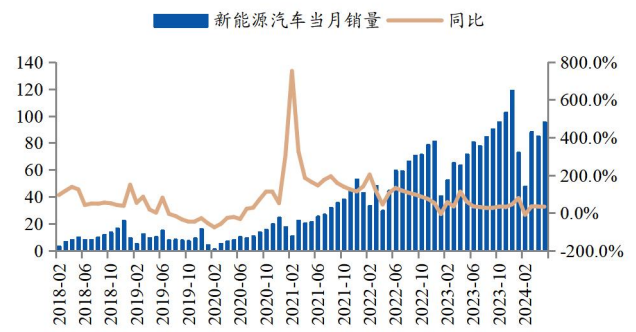
得到显著提升，新能源汽车成为 PCB 主要需求之一。

图 23: 汽车当月销量（万量）



资料来源：中汽协，财信证券

图 24: 新能源汽车当月销量



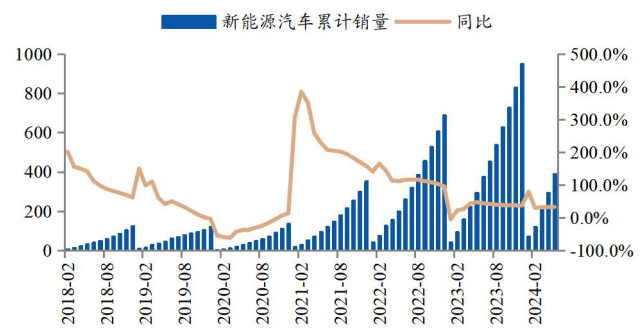
资料来源：中汽协，财信证券

图 25: 汽车全年累计销量（万辆）



资料来源：中汽协，财信证券

图 26: 新能源汽车全年累计销量（万辆）

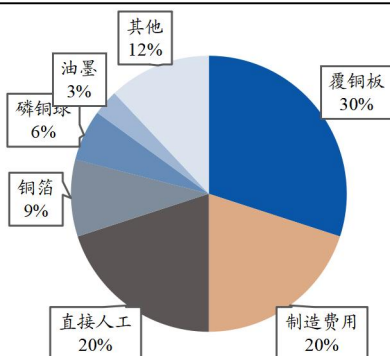


资料来源：中汽协，财信证券

3 PCB 原材料跟踪

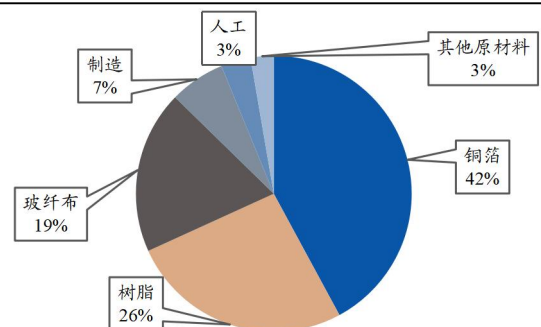
覆铜板为 PCB 核心原材料。1) PCB 成本结构中，覆铜板、铜箔、铜球、油墨等直接材料占比约 50%。覆铜板为主要原材料，占比达 30%。铜箔、磷铜球、油墨分别占 9%、6%、3%。2) 覆铜板主要原材料为铜箔、树脂和玻璃纤维。铜箔约占 42%、树脂约占 26%、玻纤布约占 19%，合计占 87%。

图 27: PCB 成本结构



资料来源：中商产业研究院，财信证券

图 28: 覆铜板成本结构

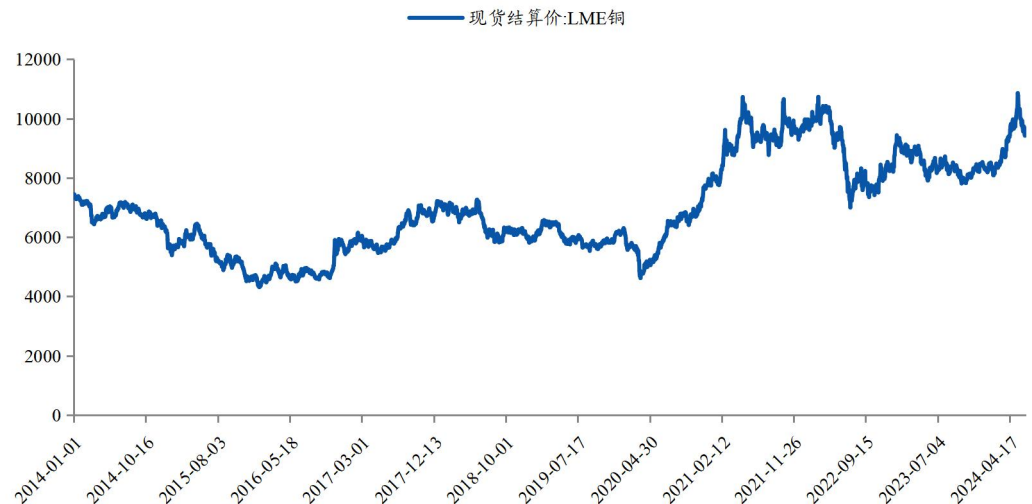


资料来源：中商产业研究院，财信证券

3.1 铜价上涨导致原材料成本波动

LME 铜现货价震荡上行后出现回调，6 月 21 日录得 9563 美元/吨，较 5 月 21 日下跌 11.2%。从历史数据看，2023 年 LME 铜现货价均值为 8477 美元/吨，与 2023 年平均水平相比，当前铜价上涨约 13%。基于前文所展示的一般 PCB、覆铜板成本结构，若铜价涨幅顺利传导，铜价每上涨 5%，覆铜板成本上涨约 2.1%，PCB 成本上涨约 1.2%。

图 29: LME 铜现货价（美元/吨）



资料来源：财信证券

3.2 覆铜板进出口情况

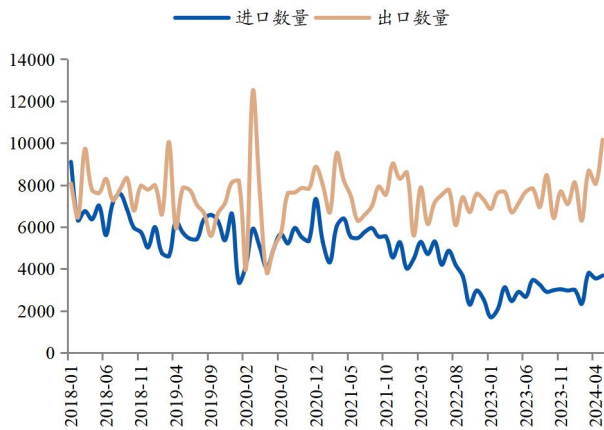
印制电路板用覆铜板进出口情况具体如下：

1) 数量上，5 月进口 3679 吨，同比+27%，环比+4%；**出口 10160 吨，同比+42%，环比+26%**。5 月进出口数量较去年同期出现较大涨幅，出口数量大涨 42%。

2) 均价上，5 月进口均价 2.54 万美元/吨，同比-10%，环比-5%；出口均价 0.61 万美元/吨，同比+0%，环比-6%。进口价格波动较大，长期震荡上行；出口价格相对稳定。

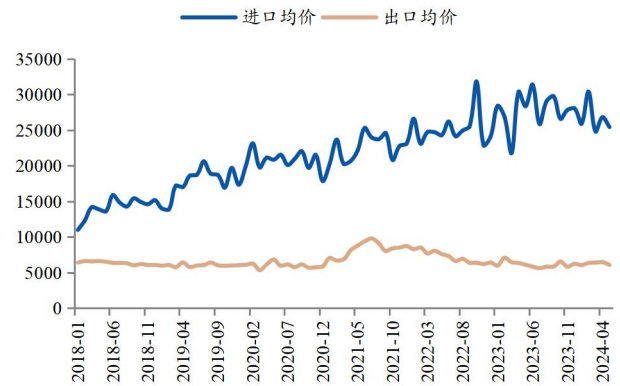
3) 金额上，5 月进口金额实现 0.94 亿美元，同比+14%，环比-2%；**出口金额实现 0.62 亿美元，同比+42%，环比+19%**。1-5 月累计进口 4.31 亿美元，同比+31%；累计出口 2.58 亿美元，同比+12%。5 月进出口金额较去年同期出现较大涨幅，其中出口金额同比大涨 42%。

图 30：印制电路用覆铜板月进出口数量（吨）



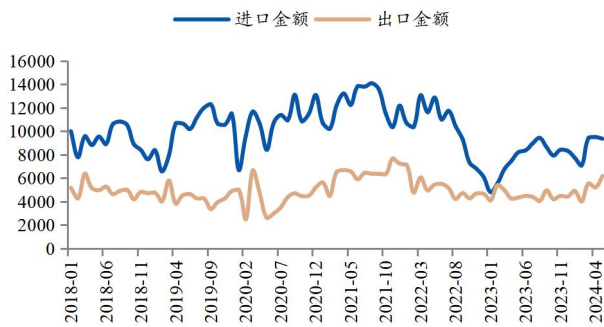
资料来源：海关总署，财信证券

图 31：印制电路用覆铜板月进出口均价（美元/吨）



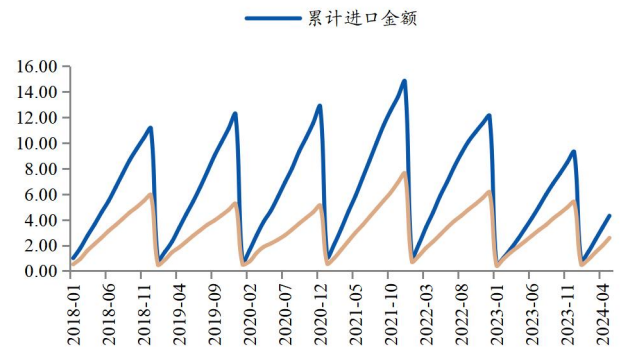
资料来源：海关总署，财信证券

图 32：印制电路用覆铜板月进出口金额（万美元）



资料来源：海关总署，财信证券

图 33：印制电路用覆铜板年进出口金额（亿美元）



资料来源：海关总署，财信证券

4 台湾半导体及 PCB 行业跟踪

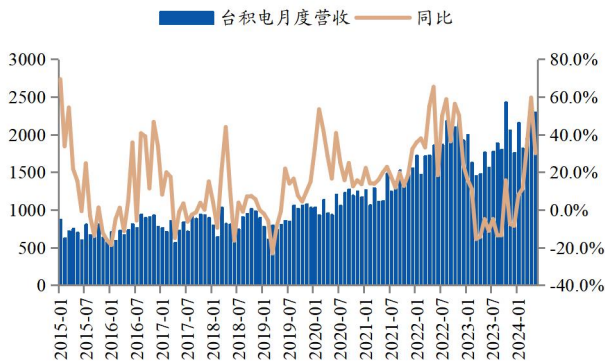
4.1 晶圆代工企业

先进制程需求旺盛，成熟制程需求有望回暖。台积电是全球晶圆代工龙头，充分受益于 AI 及高性能运算等前沿技术发展。台积电 5 月实现营收 2296 亿新台币，同比+30.1%，先进制程需求仍旺盛。联电是全球第三大晶圆代工厂，制程技术以成熟节点为主。联电 5 月实现营收 195 亿新台币，同比+3.8%，成熟制程需求有望逐步企稳回暖。

年初预计 2024 年半导体产业产值增长 10%，晶圆代工增长 20%。对于 2024 年展望，台积电表示尽管全球经济及政治状况虽然仍不明朗，不过仍旧看好今年整体半导体产业产值仍可望年增长 10%+，晶圆代工则有望年增 20%，预估台积电在美元营收年涨幅有望达到 21%-25%。2023 年，晶圆代工产业产值同比减少 13%，但台积电充分收益于 AI、HPC 发展，全年表现优于晶圆代工产业平均水平。台积电一季度法说会下调行业增速，

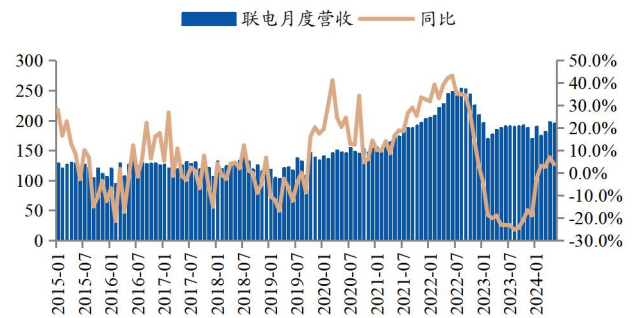
半导体市场（不含存储）预计同比增长 10%左右，晶圆代工行业预计同比增长 15-20%。

图 34: 台积电月度营收（亿新台币）



资料来源：台湾证券交易所，财信证券

图 35: 联电月度营收（亿新台币）



资料来源：台湾证券交易所，财信证券

4.2 PCB 行业营收情况

台湾 PCB 厂商营收同比持续增长，5 月营收同比+18%，1-5 月累计营收同比+6.1%。台湾 PCB 厂商 5 月实现营收 603 亿新台币，同比+12%。其中硬板厂商实现营收 450 亿新台币，同比+12%；软板厂商实现营收 153 亿新台币，同比+13%。1-5 月，台湾 PCB 厂商实现营收 2879 亿新台币，同比+7%。其中硬板厂商实现营收 2122 亿新台币，同比+7%；软板厂商实现营收 757 亿新台币，同比+8%。原材料端，覆铜板和铜箔同比增速较高。原材料厂 5 月合计营收 540 亿新台币，同比+12%。其中，CCL 厂商 334 亿新台币，同比+12%；FCCL 厂商 11 亿新台币，同比+32%；铜箔厂商 104 亿新台币，同比+18%。

表 3: 台湾 PCB 行业营收（亿新台币）

行业简称	5 月营收	同比 (%)	环比 (%)	全年累计营收	同比 (%)
PCB 厂：合计	603	12%	0%	2879	7%
硬板	450	12%	1%	2122	7%
软板	153	13%	-4%	757	8%
原材料厂：合计	540	12%	2%	2446	4%
CCL	334	12%	4%	1502	5%
FCCL	11	32%	12%	45	35%
玻璃纱/布	43	3%	3%	197	0%
铜箔	104	18%	-5%	482	-1%
其他	49	10%	1%	221	8%

资料来源：台湾电路板协会，财信证券

4.3 PCB 公司营收情况

5 月营收同比普遍增长，AI 服务器及 FPC 相关企业业绩亮眼。1) 服务器相关多层板、HDI 板企业业绩维持增长，金象电 5 月营收 34 亿新台币，同比+46%，全年营收同比+39%；欣兴 5 月营收 96 亿新台币，同比+12%，全年营收同比+4%；健鼎 5 月营收 51

亿新台币，同比+10%，全年营收同比+11%。2）FPC板5月营收同比表现亮眼。臻鼎5月营收106亿新台币，同比+29%，全年营收同比+15%；耀华5月营收17亿元，同比+21%，全年营收同比+25%。

表4：台股PCB公司5月营收情况（亿新台币）

股票代码	公司简称	业务类型	5月营收	同比（%）	环比（%）	累计营收	同比（%）
3037.TW	欣兴	载板、HDI	96	12%	3%	454	4%
8046.TW	南电	载板	27	-19%	1%	125	-36%
3189.TW	景硕	载板	25	10%	5%	119	5%
4958.TW	臻鼎	FPC、HDI	106	29%	-4%	542	15%
3044.TW	健鼎	多层板	51	10%	-6%	258	11%
2313.TW	华通	HDI、软硬结合板	57	20%	-3%	271	19%
5469.TW	瀚宇博	多层板（笔电）	35	-6%	4%	162	-8%
2368.TW	金像电	多层板（通信）	34	46%	14%	153	39%
6269.TW	台郡	FPC	27	-12%	-8%	123	-11%
2355.TW	敬鹏	多层板（汽车）	15	6%	10%	70	4%
8213.TW	志超	多层板（光电）	17	-6%	0%	76	-4%
2367.TW	耀华	FPC、软硬结合板	17	21%	-7%	77	25%

资料来源：台湾证券交易所，财信证券

5 行业及公司动态

5.1 行业新闻

5.1.1 国家集成电路产业投资基金三期成立

国家集成电路产业投资基金三期（以下简称大基金三期）股份有限公司于5月24日正式成立，注册资本3440亿人民币。大基金三期持股4%以上股东包括财政部（17.4%）、国开金融（10.5%）、国盛集团（8.7%）、工行（6.25%）、农行（6.25%）、中行（6.25%）、建行（6.25%）、交行（5.8%）、亦庄国投（5.8%）、深圳鲲鹏（4.9%）、国谊医院（4.4%）。

回顾历史，第一、二期大基金投资方向均有所侧重：1）大基金一期成立于2014年，注册资本987亿，主要任务为集成电路制造产线建设，为国产替代打下铺垫，投资领域主要集中于集成电路制造（约67%）。2）大基金二期成立于2019年，注册资本2042亿，主要任务为完善产业结构，加速国产替代，投资领域更加多元，涵盖制造、设计、封测、零部件、材料及应用等多个领域。方向是布局核心设备及关键零部件，确保产业链安全可控。3）大基金三期成立于2024年，注册资本3440亿。根据一、二期投资节奏以及当前半导体产业链发展现状，我们推测大基金三期主要任务可能是要打通关键的“卡脖子”环节，加大对核心技术、材料、零部件等领域的支持力度。

我们认为，大基金的成立是长期变量，彰显了国家对发展半导体产业、发展科技产业的决心。考虑去年下半年以来，大量先进、关键半导体设备得到进口，资本开支先行，我们判断核心技术研发、国产材料、零部件及设备将迎来重大发展机遇，建议关注AI服

务器、关键材料及设备国产替代等相关环节。

资料来源：财联社，科创板日报

5.1.2 中低端覆铜板平均涨价 10%

援引科创板日报消息，据知名分析师郭明錤最新调查，目前中低端（M4 以下）CCL（覆铜板）品项已普遍涨价，平均涨幅约接近 10%；M4 以上的高端 CCL 目前则没有涨价迹象。过去数月以来，CCL 原材料成本持续上涨，侵蚀厂商利润。郭明錤表示，本轮涨价的另一原因便是为了应对上游原材料涨价，涨价后可将原材料成本完全转嫁给客户，获利有望显著提升。

实际上，5 月下旬已有多家 CCL 厂商发出涨价通知：其中，全球 CCL 最大供应商建滔集团分别在 3 月、5 月提高报价，累计涨幅在 10%-20% 水平；梅州威利邦涨价 8%-10%；腾辉部分低价产品已涨价，涨幅 1%-2%。

资料来源：科创板日报，上海有色网

5.1.3 TechInsights：预计中国半导体产能将在五年内增长 40%

据 TechInsights 的预测，中国的半导体行业预计未来五年产能将增长 40%。这种激增是由快速的设备采购和对半导体制造设施（fabs）的战略投资推动的。

据 TechInsights 的调查数据显示，中国的硅总产能从 2018 年的 3.1 亿平方英寸增加到 2024 年预计将达到 6.31 亿平方英寸，到 2029 年将达到 8.75 亿平方英寸；产值由 2018 年的 110 亿美元增长至 2023 年的近 300 亿美元。目前产能扩张主要集中在 12 英寸晶圆厂，6 英寸和 8 英寸晶圆厂只占了少部分扩张的产能。

根据 SEAJ 披露数据，全球半导体设备销售额 2024Q1 实现 264.2 亿美元，同比-1.5%；2023 年累计实现 1062.5 亿美元，同比-1.3%。中国大陆半导体设备销售额 2024Q1 实现 125.2 亿美元，同比+113.7%；2023 年累计实现 366.0 亿美元，同比+29%。

资料来源：半导体产业网，TechInsights，SEAJ

5.2 公司动态

5.2.1 沪电股份：拟推出不超过 3000 万份股票期权激励计划

沪电股份于 6 月 3 号盘后发布公告，称结合公司和印制电路板（下称“PCB”）行业实际情况，拟筹划推出股票期权激励计划（下称“激励计划”），以促进公司持续健康发展。激励计划拟授予不超过 3000 万份股票期权，占股本总额不超过 1.57%。激励计划拟采用的公司层面业绩考核目标如下：任一考核年度加权平均净资产收益率不低于 15%，公司层面行权比例 80%；任一考核年度加权平均净资产收益率不低于 15%，且不低于同行业对标公司同期 80 分位加权平均净资产收益率，公司层面行权比例 100%。

截至 6 月 3 号收盘，沪电股份总市值 640.1 亿元，市净率 6.18，净资产 103.6 亿元。根据同花顺盈利预测综合值，公司 2021-2023 年实际 ROE 分别为 14.7%、16.5%、15.5%，2024-2026 年机构一致预测 ROE 为 19.5%、20.4%、20.2%。

资料来源：公司公告

5.2.2 鹏鼎控股：5 月合并营业同比增长 23.61%

2024 年 6 月 6 日盘后，鹏鼎控股发布 5 月营业收入简报。公司 2024 年 5 月合并营业收入为人民币 212,207 万元，较去年同期的合并营业收入增加 23.61%。

鹏鼎控股主营产品为 FPC，下游需求主要为消费电子类产品。上半年通常为消费电子需求淡季，下半年为旺季，叠加苹果开发者大会等事件刺激，端侧 AI 有望加速落地。公司产品定位中高端 PCB，有望充分受益于消费电子回暖及端侧 AI 发展，预计公司稼动率有望逐步提升，营收同比保持增长。

资料来源：公司公告

5.2.3 甬矽电子：关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告

2024 年 6 月 4 日，公司发布公告称，公司 5 月未通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购股份。截至 2024 年 5 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 2,448,321 股，占公司总股本 407,660,000 股的比例为 0.60%（上述数据保留两位小数，数据如有尾差，为四舍五入所致），回购成交的最高价为 22.31 元/股，最低价为 18.05 元/股，支付的资金总额为人民币 49,986,914.35 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

此前 2024 年 2 月 22 日，公司公告称本次回购价格不超过人民币 31.53 元/股（含），回购股份的总金额不低于人民币 4,000 万元（含），不超过人民币 6,000 万元（含），回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。

资料来源：公司公告

6 风险提示

市场需求复苏不及预期；产品技术发展不及预期；原材料供应及价格波动风险；经贸摩擦等外部环境风险。

评级系统说明

以报告发布日后的 6 - 12 个月内，所评股票/行业涨跌幅相对于同期市场指数的涨跌幅度为基准。

类别	投资评级	评级说明
股票投资评级	买入	投资收益率超越沪深 300 指数 15%以上
	增持	投资收益率相对沪深 300 指数变动幅度为 5% - 15%
	持有	投资收益率相对沪深 300 指数变动幅度为-10% - 5%
	卖出	投资收益率落后沪深 300 指数 10%以上
行业投资评级	领先大市	行业指数涨跌幅超越沪深 300 指数 5%以上
	同步大市	行业指数涨跌幅相对沪深 300 指数变动幅度为-5% - 5%
	落后大市	行业指数涨跌幅落后沪深 300 指数 5%以上

免责声明

本公司具有中国证监会核准的证券投资咨询业务资格，作者具有中国证券业协会注册分析师执业资格或相当的专业胜任能力。

本报告仅供财信证券股份有限公司客户及员工使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司当然客户。本报告仅在相关法律许可的情况下发放，并仅为提供信息而发送，概不构成任何广告。

本报告信息来源于公开资料，本公司对该信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本公司对已发报告无更新义务，若报告中所含信息发生变化，本公司可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

本报告中所指投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司及本公司员工或者关联机构不承诺投资者一定获利，不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。投资者务必注意，其据此作出的任何投资决策与本公司及本公司员工或者关联机构无关。

市场有风险，投资需谨慎。投资者不应将本报告作为投资决策的惟一参考因素，亦不应认为本报告可以取代自己的判断。在决定投资前，如有需要，投资者务必向专业人士咨询并谨慎决策。

本报告版权仅为本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人（包括本公司客户及员工）不得以任何形式复制、发表、引用或传播。

本报告由财信证券研究发展中心对许可范围内人员统一发送，任何人不得在公众媒体或其它渠道对外公开发布。任何机构和个人（包括本公司内部客户及员工）对外散发本报告的，则该机构和个人独自为此发送行为负责，本公司保留对该机构和个人追究相应法律责任的权利。

财信证券研究发展中心

网址：stock.hnchasing.com

地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 28 层

邮编：410005

电话：0731-84403360

传真：0731-84403438